

蓝思科技股份有限公司

关于与 Intel Corporation 签署合作备忘录的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次签署的备忘录主要反映双方当前阶段的合作意向与初步安排，除有关知识产权、保密与公开声明、争议解决、责任限制及法律适用等条款具有法律约束力外，其他条款不构成达成交易或特定商业结果的承诺。各重点领域下的合作内容、推进步骤、资源投入、交易结构及商业条件，双方将结合实际项目成熟度另行协商，并以双方后续签署的正式书面协议为准，后续能否签订、何时签订存在较大不确定性；

2、针对玻璃通孔（TGV）先进封装业务，受客户技术路线选择、公司推进量产时间、技术攻关进展、市场前景等多种因素影响，具有较大不确定性；

3、截至目前，TGV 先进封装业务对公司经营业绩未产生实质影响，未来公司能否、以及何时实现该领域的预期效益，存在较大不确定性，请广大投资者注意投资风险；

4、本次签订合作备忘录不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项无需提交公司董事会审议。

一、备忘录签署概况

蓝思科技股份有限公司全资子公司蓝思国际（香港）有限公司（以下合称

“蓝思科技”或“公司”）于近日与 Intel Corporation（以下简称“Intel”）签署了合作备忘录（以下简称“备忘录”）。

二、交易对手方介绍

- 1、名称：Intel Corporation
- 2、注册地址：2200 Mission College Blvd, Santa Clara, CA 95054
- 3、类似交易情况：最近三年公司未与 Intel 签署过其他类似备忘录。
- 4、Intel 在基础架构、半导体设计及全球技术标准化方面具备领先能力，与公司已有初步业务接洽，具备履约能力，不会给公司造成损失。

三、备忘录的主要内容

1、玻璃通孔（TGV）技术

双方将 TGV 先进封装作为本备忘录下讨论的重点方向，Intel 视蓝思科技为此领域有价值的潜在合作方。双方将就玻璃基板穿孔成型、高精度激光加工、金属化通孔沉积及多层互连布线等关键工艺（包括但不限于上述内容）相关的潜在合作进行讨论和评估，Intel 将提供说明性架构信息、可制造性设计（DFM）指南、基准测试方法和验证方法。

上述各项均需另行签订书面协议，任何工程验证、认证或批量生产活动均应在单独的书面协议中予以界定，并受该协议约束。

2、其他机会

除 TGV 外，双方认为在优势互补的其他领域亦存在有意义的探索潜力，例如：AI PC 的结构件和模组、数据中心服务器高可靠性结构件和散热组件，以及具身智能机器人、工业智能设备和边缘计算硬件。双方将在上述机会出现时进行讨论，任何此类合作（如有）均将在另行签订的书面协议下推进。

3、除有关知识产权、保密与公开声明、争议解决、责任限制及杂项条款明

确约定具有法律约束力外，其他条款不构成达成交易或特定商业结果的承诺。

本备忘录自双方授权代表签字之日起一年有效，期满前可经协商延长。

四、对公司的影响

公司在TGV精密加工、微孔成型、金属化沉积及多层互连等工艺方面拥有长期技术积累，已建有相关中试线并开展样品试制，目前已向部分潜在客户送样评估，部分客户已通过初步概念验证，并进入技术测试阶段。

本备忘录的签署有助于公司与Intel建立长期、稳定、互信的战略合作伙伴关系，围绕各方在各自领域（包括精密制造、材料科学及全球供应链管理）拥有雄厚专业实力与运营能力，推动相关新技术尽早实现大规模应用，促进公司中长期战略目标实现。

五、其他相关说明

本备忘录签订前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员持股未发生变动，第二大股东长沙群欣投资咨询有限公司于 2026 年 5 月 14 日向永州市慈善总会捐赠本公司 390.02 万股；截至本公告日，公司亦未收到控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员拟在未来三个月内减持公司股份的通知。未来三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员如发生股份变动情况，公司将严格按照规定履行信息披露义务。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十四日